

## Job Detail

Staff Level

Position Title	【商品開発／設計】高周波回路用SAWデバイスの商品開発（総合職）
Company Name	株式会社金沢村田製作所
Activated / Updated	2024-02-19 / 2024-02-19
Job Type	Electronics (Appliance/Semiconductor) - Production Engineering
Industry	Electronics/Consumer Electronics Manufacturing
Location	Asia Japan Ishikawa
Job Description	<p>【世界中の通信端末に搭載される電子部品を設計開発できる技術系総合職の募集です！】</p> <p>■業務概要</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・高周波回路用SAW/BAWデバイスの開発・商品化</li></ul> <p>■詳細</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・高周波回路用SAW/BAWデバイス開発等に係わるシミュレーション、試作評価</li><li>・関係部門と連携し、商品化に向けた量産移管に係わる各種業務</li><li>・試作評価する為の評価・検証環境の構築</li></ul> <p>選考フロー：</p> <p>履歴書、職務経歴書提出 ↓ 書類選考 ↓ SPI試験受験 ↓ 一次面接 ↓ 最終面接 ↓ 内定</p>
Company Info	<p>■この仕事の面白さ・魅力</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・主にスマホ用のSAW/BAWデバイス開発と商品化、及びデバイス開発に必要な周辺回路設計や特性シミュレーション解析の業務に従事いただけます。</li><li>・スマホなどの無線通信端末高周波回路における主要部品の開発を通して、快適な通信環境の創出、通信品質の向上に貢献できます。</li><li>・自らが考え実現した電子部品が、SAW/BAWデバイス世界シェアNo.1のサプライヤとして世界中の通信端末に提供できる喜びを感じることができます。</li></ul> <p>【受動喫煙対策】 屋内全面禁煙（屋外喫煙所あり）</p>
Working Hours	8:30～17:00
Qualifications	<p>■求める要件[MUST]</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・高周波商品の開発経験のある方</li><li>・プロセス開発や共通技術開発者と協働して業務遂行できる方</li><li>・電気/電子回路の基礎知識を有しており、高周波デバイスに興味がある方</li></ul> <p>■求める要件[WANT]</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・高周波SAW/BAWデバイスの知識や開発・設計経験を有している方</li><li>・高周波回路及び高周波デバイスのシミュレーション技術や評価技術を有している方</li></ul>
Japanese Level	Native Level
Salary	JPY - Japanese Yen JPY 5000K - JPY 7500K
Salary Description	489万円～768万円 (残業手当：有) ※上記目安の年収であり、 経験・スキル等を考慮の上、決定します。

Holiday Description	【休日・その他制度】123日 完全週休二日制 土曜 日曜 祝日 その他（GW/夏季・年末年始休暇） 有給休暇：有（～23日）（入社月により日数変動） 退職金：有 社会保険：健康保険 厚生年金保険 雇用保険 労災保険 寮・社宅：無 その他制度：財形貯蓄制度/従業員持株会/各種教育制度/クラブ活動/契約会員制 フィットネスクラブ
Job Contract Period	正規雇用